

## 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于拟对外投资签署合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月28日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于拟对外投资签署合作协议的议案》，同意公司与江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会签署《战略合作协议》，在无锡市滨湖区胡埭东区投资建设半导体产业化生产基地。

该项目预计投资总金额8亿元，董事会授权公司董事长及其授权人士签署本次《战略合作协议》，并全权处理本次建设半导体产业化生产基地相关的所有事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项在董事会的决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

### 二、协议对方的基本情况

江苏省无锡蠡园经济开发区地处无锡城市中心地带，辖区内共集聚企业4000余家，近年来一直聚焦集成电路设计产业链，依托中科芯、清华大学应用研究院、十一科技等龙头央企，汇集技术项目、金融资本、高端人才等产业要素，着力打造无锡滨湖集成电路设计产业生态圈。园区现有集成电路设计及相关类企业近百家，2019年销售收入总额突破36亿元，同比增长20%。

公司与江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会不存在关联关系。

### 三、合作协议的主要内容

#### （一）协议主体

甲方：江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会

乙方：江苏卓胜微电子股份有限公司

## （二）投资项目的基本情况

项目名称：芯卓半导体产业化建设项目（以最终备案为准）

项目建设内容：建设 SAW 滤波器晶圆生产和射频模组封装测试生产线，及厂房的配套设施建设及软硬件设备购置，开展关键技术和工艺的研发及产品的产业化生产。

项目用地：项目拟用地占地约 150 亩（地块位于：滨湖区刘闾路与洋溪河交叉口东南侧），土地用途为工业用地，土地使用权年限为 50 年。上述项目实际用地面积及位置以《国有建设用地使用权出让合同》约定为准。

项目投资规模：项目总投资 8 亿元人民币。

甲方给予乙方基金支持、产业支持、发展奖励、建设奖励、人才政策、争取省市政策支持等一系列政策支持。

## （三）甲乙双方的主要权利和义务

甲方支持乙方享受国家、省、市现行有关投资及产业优惠政策，并按照招商引资相关工作制度，做好项目的推进服务工作。

甲方有义务协助乙方办理该项目及配套设施所涉及的土地、规划、环保、建设、立项等事项，甲方指派专人联系乙方，做好项目推进服务工作。

为了扶持该项目建设发展，甲方承诺对于乙方在该项目中购买设备的金额，由工信局核定后，甲方按照设备投资额的一定比例进行奖励。

甲方保证乙方在符合相关政策条件的情况下，享受各类普惠奖励和优惠政策，不与协议中其他奖励、补助等冲抵。

## 四、对外投资的目的及公司的影响

公司基于在射频前端领域丰富的技术储备、对需求的精准把握和稳定的客户资源，开展芯卓半导体产业化建设项目，针对射频 SAW 滤波器芯片和射频模组产品，导入射频 SAW 滤波器工艺技术与制造设备，形成工艺技术能力和规模化量产能力，抢位射频 SAW 滤波器市场份额，实现射频 SAW 滤波器芯片和模组的产业化目标。

通过建设晶圆制造和封装测试生产线，项目建成后，将提升公司在射频 SAW 滤波器领域的整体工艺技术能力和模组量产能力，实现射频 SAW 滤波器芯片和射频模组的全产业链布局，提升公司的自主研发创新能力和市场竞争力，最终实现射频 SAW 滤波器芯片和射频模组的国产替代。

公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营的独立性造成不利

影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司不会因此而对交易对方形成业务依赖。短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 五、风险提示

1、本次对外投资是基于公司战略发展需求和整体业务规划而做出的慎重决策，但仍存在一定的政策风险及项目实施风险。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化、建设周期进度不及预期等，项目的实施可能存在延期、变更或终止等不确定风险，但不会对公司目前的生产经营产生重大影响。

2、公司深耕集成电路多年，具有丰富的集成电路研发设计和供应链管理能力和经验，并且通过与供应商合作共建生产专线等方式积累了丰富的管理及运营经验，但自建晶圆制造和封装测试生产线复杂度较高，研发、运营和管理人员将相应增加。如果公司未能根据业务发展状况及时提升人力资源、法律、财务等方面的管理能力，可能会影响项目研发建设进程，导致项目未能按期投入运营的风险。

3、虽然历史上公司不乏与晶圆制造供应商及封装测试供应商合作开发晶圆制造工艺和封装测试工艺的经验，但毕竟工艺技术的开发难度较高，公司缺乏独自成功研制相关技术和工艺的经验，如果公司未来未能根据建设目标及时开发出满足市场需求的技术及工艺，将可能导致本项目的实施存在不确定性，并对公司的生产经营产生一定影响。

## 六、其他

公司将根据相关事项的进展或变化情况，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 七、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、第二届监事会第三次会议决议；
- 3、《战略合作协议》。

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司  
董事会

2020年11月28日